

2026 年 10 月吉日
エスペック株式会社

エスペック信頼性セミナー2026 のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、先端半導体パッケージやパワー半導体の高性能化に伴い、熱や信頼性に関する評価技術の重要性がますます高まっています。

このたび「エスペック信頼性セミナー2026」では、先端半導体における信頼性課題と評価技術、ならびに次世代パワーデバイスを支えるエスペックの熱・信頼性評価技術についてご紹介いたします。

ご多用とは存じますが、ぜひご聴講賜りますようお願い申し上げます。皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。

敬具

記

開催要項

日 時：2026 年 11 月 25 日（水） 13:30～16:30

場 所：オンラインでの開催（事前申込が必要です）

テ ー マ：『半導体パッケージ、パワー半導体向けの信頼性評価技術の最新動向』

受 講 料：無料

申込方法：下記 URL の WEB サイトよりお申し込みください。

セミナー会場への入場には弊社から別途ご案内する入場キー(URL)が必要となりますので、必ず以下のお申し込みフォームへ登録をお願いします。

締切日：2026 年 11 月 18 日（水）

■ お申し込みフォームはコチラ ↓ ↓ ■

https://espec.satori.site/reliability_seminar

* 先着順での受付となりますのでお早めに申し込みください。

* 当社同業の企業様からの申し込みはご遠慮いただく場合がございます。予めご了承ください。

<問合せ先>

エスペック信頼性セミナー2026 事務局

[Mail] g-ryuu@espec.co.jp

[Tel] 06-6358-4751

講演概要

〔招待講演 1〕

▶パワーモジュール熱設計を支える計測連携シミュレーションの紹介

発表：株式会社先端力学シミュレーション研究所

技術開発部 基盤技術開発室室長 前澤 祐 様



「概要」

小型化・高密度化が進むパワーモジュールでは、放熱性能と信頼性の両立が重要です。本講演では、実測が難しい内部の温度・変形・熱応力を可視化するシミュレーションの基本から、寿命評価への応用までを分かりやすく解説します。さらに計測結果との連携によりシミュレーション精度を向上させるアプローチと、動作中の実機モジュールの変形をミクロン単位で同定したシミュレーションによる内部評価の事例を紹介し

〔一般講演〕

▶次世代パワーデバイスを支えるエスベックの熱・信頼性評価技術

発表：エスベック株式会社 カスタム機器本部 SI 部

開発設計グループ リーダー 菅 則人



「概要」

次世代パワーデバイスでは、低熱抵抗化や高出力化により、熱設計と信頼性評価の重要性がますます高まっています。本セミナーでは、豊富な導入実績を有するパワーサイクル試験装置に加え、過渡熱抵抗測定・構造関数による熱構造解析技術への取り組みを紹介し、デバイス開発・品質評価を支えるソリューションをご提案します。

〔招待講演 2〕

▶先端半導体パッケージ・パワー半導体における信頼性課題と評価技術

発表：大阪大学 産業科学研究所

フレキシブル 3D 実装協働研究所 吉田 浩芳 様



「概要」

'AI・HPC の進展に伴い、チップレットなど先端半導体パッケージの信頼性確保が重要となっている。一方、車載パワーデバイスに代表されるパワー半導体パッケージでも信頼性評価技術が進展している。本講演では、ロードマップ等から技術動向と今後の課題を概説し、品質検査、通電を伴う信頼性評価、故障解析などの評価技術と最新の標準化動向について解説します。

以上